

8000 CS

半导体系列

高速芯片分选设备

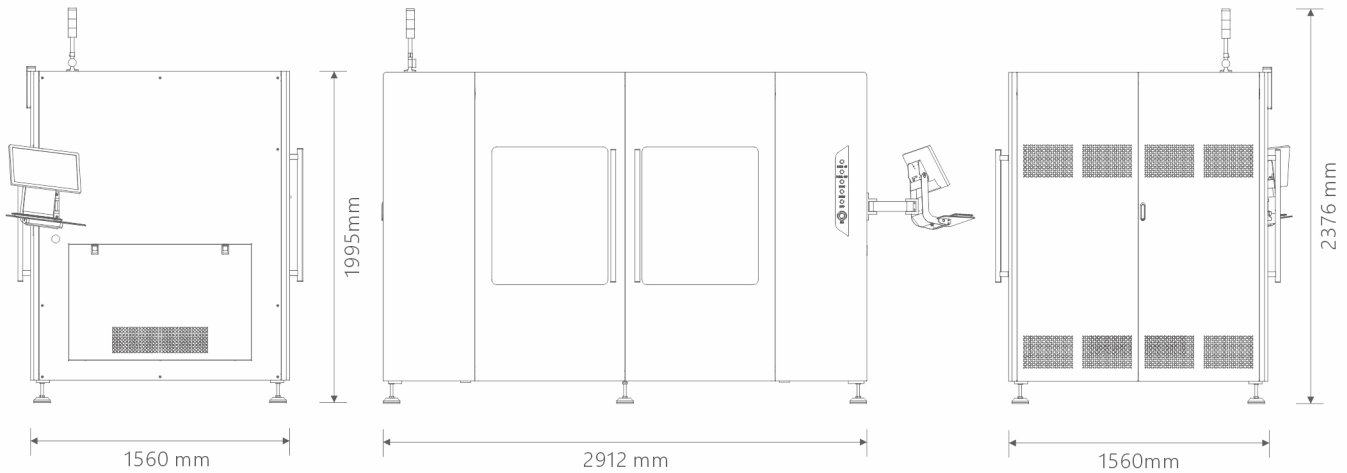


Cencorp 8000 CS配备两个标准分选头模组,可处理大尺寸芯片、托盘、异型夹具。长对接窗口使其可以更灵活适用各种工艺设备,如测试设备、检查设备、固晶设备。

- 一键式夹头自动更换
- 在线托盘更换,停机时间短
- 每小时产能(UPH)最高可达8000
- 支持产品ID扫描和坏板识别
- 自主研发软件系统
- 支持MES追溯系统和本地数据管理系统

8000 CS

技术参数



设备基本参数

宽度: 2912mm
深度: 1560mm
高度: 1995mm
重量: 2800kg

设备精度

重复定位精度 (x, y, z): ± 0.002 mm
系统精度: ± 0.01 mm

芯片处理能力

最小芯片尺寸(x*y): 1x1 mm
最大芯片尺寸(x*y): 30x30 mm

基础功能

安全互锁门
吸嘴间距可调节
平均无故障间隔时间: 168小时
平均辅助间隔时间: 4小时
平均修复时间: 15分钟
平均辅助时间: 3分钟
静电防护等级: 0级
噪音: < 75dB

用户界面

运行系统: Windows
网络连接: 可选

视觉系统

多种视觉工具
基础点识别时间
产品ID识别
视觉飞拍功能

可选功能

条码类型: 1D or 2D
支持SECS/GEM
绝对精度校准
支持MES追溯系统
本地数据管理系统
离线编程

轴性能

最大轴速度: 2000 mm/s
最大轴加速度: 15000mm/s²

电气要求

电压: 交流 400/208V
频率: 50/60Hz
最大功率: 4KW

气源要求

气压: 5-7 bar
预计消耗气量: 100 L/min

环境要求

工作温度: 10-40°C
工作湿度: 30%-85%